

CHIPS JU: Prehľad otvorených výziev



Ing. Viktória Vörösová
SK CHIPS

Call	Dates	Info
Call for Design Enablement Teams	7.7.26-17.9.26	CSA, EU funding only, One stage call, 5M€ (0,5M/project), reimbursment rate: profit org. 100%, SME 100%, University 100%
AI chips and systems for EU compute infrastructure	7.7.26-17.9.26	Grant for Procurement, Co-funded with NFA, One stage call, 100M€, eimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%, University 50%
Skills Hubs of Excellence	7.7.26-17.9.26	Simple Grant, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€ (10M/project), reimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%, University 50%
Pilot Federation	7.7.26-17.9.26	Simple Grant, Co-funded with NFA, One stage call, 10M€, reimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%, University 50%
Stimulation of Chips Design	7.7.26-17.9.26	CSA, EU funding only, One stage call, 15M€, reimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%, University 50%)
International collaboration - Joint call EU and Japan on semiconductors	7.7.26-17.9.26	Simple Grant, Co-funded with NFA, One stage call, 15M€ (5M/project), reimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%, University 50%
Quantum Chips Design: Driving Europe's Quantum Design Ecosystem and Enabling Quantum Design Tools Innovation	7.7.26-17.9.26	RIA, Co-funded with NFA, One stage call, 30M€, reimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%, University 50%
Quantum Chips: Enabling Technologies	7.7.26-17.9.26	RIA, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€ (5-7M/project), reimbursment rate: profit org. 50%, SME 50%, University 50%

Call	Dates	Info
IA Global call according to SRIA 2026	3.2.26 - 7.5.26/17.9.26	IA, Co-funded with NFA, Two stage call, 40M€ (15M/project), reimbursement rate: profit org. 20%, SME 30%, university 35%
IA Resilience call reinforcing Europe's strength in power electronics	7.7.26-17.9.26	IA, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€ (10M/project), reimbursement rate: profit org. 25%, SME 35%, university 35%
IA Resilience call reinforcing Europe's strength in photonics	7.7.26-17.9.26	IA, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€ (10M/project), reimbursement rate: profit org. 25%, SME 35%, university 35%
IA Resilience call reinforcing Europe's strength in health	7.7.26-17.9.26	IA, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€, reimbursement rate: profit org. 25%, SME 35%, university 35%
Global call according to SRIA 2026 (RIA)	3.2.26 - 7.5.26/17.9.26	RIA, Co-funded with NFA, Two stage call, 50M€ (12M/project), reimbursement rate: profit org. 25%, SME 35%, university 35%
RIA Resilience call reinforcing Europe's strength in 6G radio communication systems	7.7.26-17.9.26	RIA, Co-funded with NFA, One stage call, 20M€, reimbursement rate: profit org. 25%, SME 35%, university 35%
Call with Digital Partnership and TTC countries	7.7.26-17.9.26	RIA, No co-financing by Chips JU Participating States following Article 141(2) SBA, One stage call, 5M€ (2-2,5M/project), reimbursement rate: profit org. 100%, SME 100%, university 100%
Supply chain resilience	7.7.26-17.9.26	CSA, No co-financing by Chips JU Participating States following Article 141(2) SBA, One stage call, 2M€, reimbursement rate: profit org. 100%, SME 100%, university 100%
Coordination of the European software-defined vehicle platform	7.7.26-17.9.26	CSA, EU funding only, One stage call, 2M€, reimbursement rate: profit org. 100%, SME 100%, university 100%

Výzva: DIGITAL-JU-CHIPS-2026-DET-CSA

Typ: CSA | 100 % financovanie z EÚ

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Rozpočet: 5 mil. € celkom | cca 0,5 mil. € / projekt

Hlavná úloha DETs

- poskytovať **end-to-end podporu návrhu čipov**
- prevádzkovať **bezpečné cloudové návrhové prostredia**
- sprístupniť **EDA nástroje a PDK/ADK**
- prepájať používateľov s **European Design Platform** a pilotnými linkami

Cieľ výzvy

Vybudovať **Design Enablement Teams (DETs)** ako distribuované uzly v rámci **European Design Platform**.

Očakávaný prínos

- nižšie bariéry pre návrh čipov v Európe
- rýchlejší prechod **od návrhu k výrobe**
- dostupná podpora pre široké spektrum technológií
- silnejšie prepojenie dizajnu, prototypovania a výroby

Výzva: DIGITAL-JU-CHIPS-2026-AIDP-GfP

Typ: Pre-commercial Procurement (PCP)

Rozpočet: 100 mil. €

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Financovanie: 50 % (Co-funded with NFA)

Cieľ výzvy

Podporiť vývoj **suverénnych európskych AI čipov a rackových AI systémov** pre budúcu výpočtovú infraštruktúru EÚ.

Čo sa bude podporovať

- vývoj riešení v **3 fázach** od TRL 5 po TRL 8
- **AI čipy, AI systémy a pilotné dodávky**
- testovanie, spracovanie dát a validácia **v EÚ**
- prepojenie na **Design Platform, pilotné linky a kompetenčné centrá**

Očakávaný prínos

- zníženie závislosti EÚ od mimoeurópskych dodávateľov
- porovnávacie testovanie európskych AI riešení
- posilnenie európskeho AI hardvérového ekosystému
- základ pre budúce komerčné nasadenie

Výzva: DIGITAL-JU-CHIPS-2026-SKILLS-HoE-SG

Typ: Simple Grant (spolufinancované)

Rozpočet: 20 mil. € | do 10 mil. € / projekt

Trvanie: min. 5 rokov

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Financovanie: 50 %

Cieľ výzvy

Vybudovať **európske centrá excelentnosti pre polovodičové zručnosti** v úzkej spolupráci s priemyslom.

Čo sa bude podporovať

- dlhodobé vzdelávacie programy (Bc., Mgr., PhD)
- **praktické (hands-on) vzdelávanie** na pilotných linkách
- stáže, mobilita a spolupráca s priemyslom
- podpora STEM, diverzity a inklúzie

Očakávaný prínos

- viac **kvalifikovaných talentov** pre polovodičový priemysel
- udržateľné vzdelávacie centrá v EÚ
- širší a diverzifikovaný talent pool
- príspevok k technologickej suverenite EÚ

Výzva: DIGITAL-JU-CHIPS-2026-SKILLS-PF-SG

Typ: Simple Grant (spolufinancované)

Rozpočet: 10 mil. €

Trvanie: min. 5 rokov

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Financovanie: 50 %

Cieľ výzvy

Vytvoriť európsku federáciu poskytovateľov odborného vzdelávania (VET) v oblasti polovodičov.

Čo sa bude podporovať

- prepájanie VET poskytovateľov naprieč Európou
- zosúladenie kvalifikácií, certifikácií a kurikúl
- rekvalifikácia, upskilling a celoživotné vzdelávanie technikov
- rozvoj mikro-kvalifikácií a cezhraničnej mobility

Očakávaný prínos

- viac kvalifikovaných technikov pre polovodičový priemysel
- prenositeľné certifikácie uznávané v EÚ
- silnejšia mobilita pracovnej sily
- dlhodobo udržateľná európska vzdelávacia sieť

Výzva: DIGITAL-JU-CHIPS-2026-SKILLS-SCD-CSA

Typ: CSA (100 % EÚ)

Rozpočet: 15 mil. €

Trvanie: 4 roky

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Cieľ výzvy

Sprístupniť **návrh a výrobu čipov študentom** naprieč celou Európou.

Čo sa bude podporovať

- zapojenie študentov (SŠ aj VŠ) do návrhu čipov
- prepojenie škôl s univerzitami, centrami a priemyslom
- integrácia s **EUROPRACTICE** a **European Design Platform**
- podpora návrhových nástrojov a vzdelávacích materiálov

Očakávaný prínos

- **tape-out programy pre $\geq 1\ 000$ študentov**
- praktické skúsenosti s návrhom čipov
- rozvoj talentov v mikroelektronike
- silnejšie prepojenie vzdelávania a priemyslu

Výzva: DIGITAL-JU-Chips-2026-SG-JAPAN

Typ: Simple Grant (spolufinancované)

Rozpočet: 15 mil. € | cca 5 mil. € / projekt

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Financovanie: 50 %

Max. príspevok EÚ: 30 % na partnera

Cieľ výzvy

Podporiť **spoluprácu EÚ a Japonska** vo výskume a vývoji pokročilých polovodičových technológií.

Čo sa bude podporovať

- **chiptetové technológie** a 2.5D/3D integrácia
- pokročilé výrobné procesy
- technológie **pod 2 nm**
- medziodborový výskum prepájajúci materiály, zariadenia a AI

Očakávaný prínos

- pokročilá heterogénna integrácia pre AI aplikácie
- štandardizované chiptetové rozhrania
- validácia riešení v laboratórnom a pilotnom prostredí
- silnejšie strategické partnerstvo medzi EÚ a Japonskom

Výzva: HORIZON-JU-CHIPS-2026-QUANTUM-1-RIA

Typ: RIA (spolufinancované)

Rozpočet: 30 mil. €

Trvanie: 36–48 mesiacov

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Financovanie: 50 %

Cieľ výzvy

Vybudovať európsky ekosystém pre návrh kvantových čipov a rozvoj dizajnových nástrojov.

Čo sa bude podporovať

- vývoj a validácia nástrojov pre kvantový dizajn (EDA, PDK, knižnice)
- end-to-end návrhové toky vrátane cloudového prístupu
- integrácia s European Design Platform a pilotnými linkami
- prístup k MPW (Multi-Project Wafer)

Očakávaný prínos

- európske centrum kvantového dizajnu
- dostupné (aj open-source) nástroje pre kvantový návrh
- funkčné návrhové toky pre akademickú obec a MSP
- posilnenie konkurencieschopnosti EÚ v kvantových technológiách

Výzva: HORIZON-JU-CHIPS-2026-
QUANTUM-2-RIA

Typ: RIA (spolufinancované)

Rozpočet: 20 mil. € | 5–7 mil. € / projekt

Trvanie: 36 mesiacov

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Financovanie: 50 %

Cieľ výzvy

Podporiť vývoj **technológií potrebných pre fungovanie kvantových systémov** (mimo samotných kvantových čipov).

Čo sa bude podporovať

- riadiaca a odčítacia elektronika (vrátane kryogénnej)
- fotonické a optické komponenty
- prepojovacie technológie, balenie a integrácia
- systémová integrácia a validácia v EÚ

Očakávaný prínos

- škálovateľné a miniaturizované kvantové systémy
- overená výrobitelnosť a spoľahlivosť
- silnejší európsky dodávateľský reťazec
- zníženie závislosti od mimoeurópskych technológií

Výzva: HORIZON-JU-Chips-2026-1-IA

Typ: Inovačná akcia (IA)

Rozpočet: 40 mil. € | ~15 mil. € / projekt

Termín: 2-kolová výzva

- PO: 7. máj 2026
- FPP: 17. september 2026

Financovanie: 20–35 %

Cieľ výzvy

Podporiť inovačné projekty naprieč celým ECS ekosystémom v súlade so strategickou agendou SRIA 2026.

Čo sa bude podporovať

- široké spektrum tém: čipy, výroba, AI, edge computing, softvér
- väčšinou **otvorené témy** (s niekoľkými prioritami)
- aplikácie napr.:
 - mobilita
 - energetika
 - zdravotníctvo
- projekty na úrovni **TRL 5–8**

Očakávaný prínos

- vývoj a nasadenie nových technológií v praxi
- silné prepojenie výskumu a priemyslu
- podpora MSP a inovačných ekosystémov
- prínos pre konkurencieschopnosť EÚ

Výzva: HORIZON-JU-Chips-2026-FT1-IA

Typ: Inovačná akcia (IA)

Rozpočet: 20 mil. € | do 10 mil. € / projekt

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Financovanie: 25–35 %

Cieľ výzvy

Posilniť **odolnosť a vedúcu pozíciu Európy** v oblasti výkonovej elektroniky.

Čo sa bude podporovať

- technológie **Wide Bandgap (GaN, SiC)**
- pokročilé výrobné procesy a 300 mm platformy
- nové výkonové polovodiče a integrácia
- využitie AI a dátovo riadených metód

Očakávaný prínos

- silnejší európsky ekosystém výkonovej elektroniky
- zabezpečenie dodávok kritických materiálov
- zníženie závislosti od mimoeurópskych dodávateľov
- rýchlejší vývoj a uvedenie na trh

Výzva: HORIZON-JU-Chips-2026-FT2-IA

Typ: Inovačná akcia (IA)

Rozpočet: 20 mil. € | do 10 mil. € / projekt

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Financovanie: 25–35 %

Cieľ výzvy

Posilniť odolnosť a vedúcu pozíciu Európy vo fotonike.

Čo sa bude podporovať

- škálovanie fotonických technológií (SiN, InP, GaAs)
- pokročilé balenie a testovanie (co-packaged optics)
- integrácia aktívnych komponentov (lasery, detektory...)
- systémové demonštrácie v aplikáciách (AI, komunikácia, senzory)

Očakávaný prínos

- demonštrátory blízke trhu (TRL 7–8)
- škálovateľná a spoľahlivá výroba
- silnejšie európske dodávateľské reťazce
- rýchlejší prechod na trh

Výzva: HORIZON-JU-Chips-2026-FT3-IA

Typ: Inovačná akcia (IA)

Rozpočet: 20 mil. € | do 20 mil. € / projekt

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Financovanie: 25–35 %

Cieľ výzvy

Posilniť **odolnosť a inovácie v európskom zdravotníctve** prostredníctvom ECS technológií.

Čo sa bude podporovať

- nositeľné zdravotnícke riešenia a biosenzory
- AI-podporované zobrazovanie a diagnostika
- pokročilé laboratórne a vedecké nástroje
- digitálne zdravotnícke systémy (edge-to-cloud, AI)

Očakávaný prínos

- personalizovaná zdravotná starostlivosť
- kontinuálne monitorovanie pacientov
- včasná diagnostika a prevencia ochorení
- efektívnejšie a škálovateľné zdravotnícke systémy

Výzva: HORIZON-JU-Chips-2026-1-RIA

Typ: Research & Innovation Action (RIA)

Rozpočet: 50 mil. € | ~12 mil. € / projekt

Termín: 2-kolová výzva

- PO: 7. máj 2026
- FPP: 17. september 2026

Financovanie: 25–35 %

Cieľ výzvy

Podporiť **výskum a vývoj nových technológií** naprieč celým ECS ekosystémom.

Čo sa bude podporovať

- široké spektrum tém (čipy, AI, výroba, systémy...)
- väčšinou **otvorené témy (bottom-up)**
- aplikácie: mobilita, energetika, priemysel, zdravotníctvo
- projekty na úrovni **TRL 3–4**

Očakávaný prínos

- nové poznatky a technologické riešenia
- overenie konceptov (proof of concept)
- spolupráca výskum – priemysel – MSP
- základ pre budúce inovačné projekty

Výzva: HORIZON-JU-Chips-2026-2-RIA

Typ: Research & Innovation Action (RIA)

Rozpočet: 20 mil. € | do 20 mil. € / projekt

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Financovanie: 25–35 %

Cieľ výzvy

Posilniť **pozíciu Európy v 6G a RF technológiách** pre budúcu konektivitu.

Čo sa bude podporovať

- RF front-end technológie pre komunikáciu
- pokročilé vysielacie, prijímače a filtre
- anténne systémy (massive MIMO, beamforming)
- integrácia a testovanie systémov

Očakávaný prínos

- vyššie dátové rýchlosti a efektívnejšie využitie spektra
- energeticky úspornejšie riešenia
- pokrok smerom k 6G (IMT-2030)
- posilnenie európskeho technologického ekosystému.

Výzva: HORIZON-JU-Chips-2026-3-RIA

Typ: Research & Innovation Action (RIA)

Financovanie: 100 % (len EÚ)

Rozpočet: 5 mil. € | ~2–2,5 mil. € / projekt

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Cieľ výzvy

Podporiť **spoluprácu EÚ s partnerskými krajinami** v oblasti polovodičových technológií.

Čo sa bude podporovať

- výskum v mikro- a nanoelektronike
- nové materiály a technologické koncepty
- pokročilé balenie a integrácia
- spolupráca s partnermi (napr. India, Singapur, Taiwan)

Očakávaný prínos

- silnejšie medzinárodné partnerstvá
- nové technologické riešenia (napr. neuromorfné systémy)
- rozvoj dodávateľských reťazcov
- posilnenie globálnej pozície EÚ

Výzva: HORIZON-JU-Chips-2026-CSA

Typ: Coordination and Support Action (CSA)

Financovanie: 100 % z EÚ

Rozpočet: 2 mil. €

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Cieľ výzvy

Zlepšiť prehľad o európskom polovodičovom dodávateľskom reťazci a posilniť jeho odolnosť voči narušeniam.

Čo sa bude podporovať

- zber a prepájanie dát naprieč hodnotovým reťazcom
- vytvorenie katalógu firiem, produktov a služieb
- stresové testovanie a analýza rizík
- spolupráca medzi firmami, MSP a verejnými aktérmi

Očakávaný prínos

- bezpečná dátová platforma / digitálne dvojča dodávateľského reťazca
- lepšie mapovanie kapacít a závislostí
- mechanizmy včasného varovania
- odporúčania pre firmy, členské štáty a EK

Výzva: HORIZON-JU-Chips-2026-SDV-CSA

Typ: Coordination and Support Action (CSA)

Financovanie: 100 % z EÚ

Rozpočet: 2 mil. €

Termín: 7. júl 2026 – 17. september 2026

Cieľ výzvy

Koordinovať a rozvíjať **spoločnú európsku platformu pre Software-Defined Vehicles (SDV)**

Čo sa bude podporovať

- koordinácia a riadenie SDV platformy
- aktualizácia roadmapy a architektúry
- prepájanie projektov a iniciatív v EÚ
- podpora open-source riešení a spolupráce

Očakávaný prínos

- silný a koordinovaný SDV ekosystém v Európe
- spoločná referenčná architektúra
- lepšia spolupráca medzi firmami, výskumom a štátmi
- prepojenie na globálne iniciatívy

CHIPS JU: Prehľad otvorených výziev

